Informations de base

2018/2947(DEA)

DEA - Procédure d'acte délégué

Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

Complétant 2008/0240(COD)

Subject

3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Portail de documentation

Commission Européenne

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base non législatif	C(2018)07499	16/11/2018	
Document annexé à la procédure	C(2025)5889	25/08/2025	